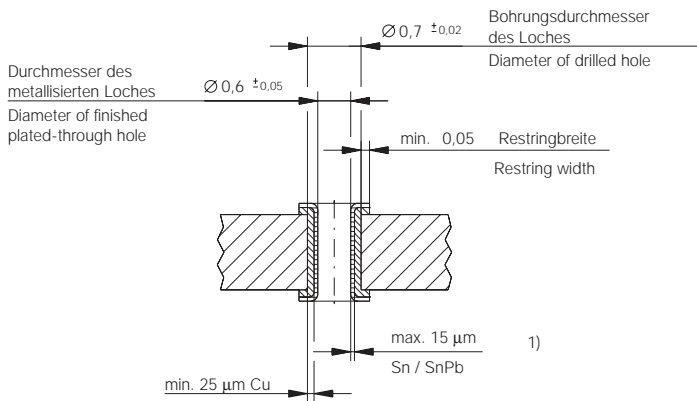


Schichtaufbau im metallisierten Loch für SMC Steckverbinder Plated-thru-hole specification for SMC connectors

Schichtaufbau im metallisierten Loch (IEC 60352-5) mit **Nennendurchmesser $\varnothing 0.6$ mm** für Einpress-Signalkontakt
Plated thru-hole specification (IEC 60352-5) with **nominal diameter $\varnothing 0.6$ mm** for pressfit signal contact



- 1) Werden andere Oberflächentechniken, wie z.B. NiAu, chem. Sn oder Cu blank eingesetzt, sind die angegebenen Maße für Bohrungsdurchmesser, Durchmesser des metallisierten Loches, Restringbreite und die Mindestschichtdicke von Cu einzuhalten.
Ein mögliches Überschreiten der oberen Toleranz von Maß "Durchmesser des metallisierten Loches" wird durch eine entsprechende Cu-Schichtdicke vermieden.

For other platings, such as NiAu, chem. Sn or blanc Cu the recommended dimensions have to be respected for the diameter of drilled hole, diameter of plated-thru hole, rest ring width and min. thickness of Cu plating.

To keep the max. tolerance for the "Diameter of finished plated-thru hole" the according thickness of the Cu-plating has to be used.